

# ( 遠距 ) 雷射在半導體產業應用技術 種子師資培訓班

## ■ 課程簡介：

在經濟部產業專業人才發展推動計畫指導下，為協助推動技專校院人才發展計畫，培育人才，盼藉由雷射在半導體產業應用技術種子師資培訓班，邀請對雷射技術議題有研究的老師，藉由課程了解雷射加工技術與應用實例，快速了解雷射產業，並將雷射原理及整合應用之各專業概念作分析與專業課程內容介紹，期能有助於教師從培訓課程的設計及經驗，導入業界人才需求之課程，以提升學生實務之教學品質。

## 課程大綱：

| 111 年 10 月 27 日 (四) |   |   |
|---------------------|---|---|
| 時間                  | 課程名稱及大綱   | 講師  |
| 09:30-12:30         | <b>一、雷射加工技術應用於先進封裝製程</b><br>1.雷射原理與加工系統簡介<br>2.雷射鑽孔在先進封裝製程應用<br>3.雷射切割應用於半導體製程<br>4.雷射曝光技術與系統簡介 | <b>陳育斌</b> 副總經理<br>東台精機股份有限公司<br>電子設備事業處                |
| 12:30-13:30         | 午餐  |   |
| 13:30-16:30         | <b>二、雷射加工技術於光電半導體薄膜製程應用</b><br>1.雷射製程設備再製造領域機會與市場<br>2.雷射於光電與半導體材料應用<br>3.個案分析介紹                | <b>蕭文澤</b> 博士<br>財團法人國家實驗研究院<br>台灣儀器科技研究中心<br>生醫與曝光機系統組 |
| 111 年 10 月 28 日 (五) |   |   |
| 時間                  | 課程名稱及大綱   | 講師  |
| 09:30-12:30         | <b>三、雷射精密切割玻璃基板技術</b><br>1.雷射應用範圍<br>2.玻璃基板切割方法<br>3.雷射切割玻璃技術與裝置<br>4.雷射安全                      | <b>曾釋鋒</b> 副教授<br>國立臺北科技大學<br>機械工程系                     |
| 12:30-13:30         | 午餐  |   |
| 13:30-16:30         | <b>四、雷射表面處理應用技術與實例</b><br>1.雷射表面微加工技術與實例<br>2.雷射表面熔覆技術與實例<br>3.雷射表面改質技術與實例                      | <b>陳天青</b> 總經理<br>精鐳光電科技(股)有限公司                         |

※主辦單位得因不可抗拒因素，保留本培訓班內容及講師異動之權利。

## 【 開 課 資 訊 】

- 主辦單位：財團法人工業技術研究院
- 承辦單位：社團法人台灣電子設備協會
- 舉辦地點：線上課程
- 舉辦日期：111年10月27-28日(四五)09:30-16:30 (兩天共12小時)
- 課程費用：免費，限大專院校相關系所教師報名，不含教職員及學生。
- 報名方式：
  - 1.網路報名：<https://www.teeia.org.tw/zh-tw/Course/1111027-28/155>
  - 2.請於報名後，提供教師證或名片影本 e-mail 至 [vivi@teeia.org.tw](mailto:vivi@teeia.org.tw)，以利確認查核。
  - 3.2日課程皆需出席，結業時將發給教師種子師資培育時數證明。
- 報名聯絡人：

TEL：02-27293933 ext.17 楊小姐, ext.22 鄭小姐

FAX：02-27293950

E-mail：[vivi@teeia.org.tw](mailto:vivi@teeia.org.tw)、[anne@teeia.org.tw](mailto:anne@teeia.org.tw)
- 注意事項：
  1. 完成線上報名後，系統會發送『報名通知信』至您的 email 信箱，如未收到請來電確認。
  2. 為尊重講師之智慧財產權益，恕無法提供課程講義電子檔。
  3. 為配合講師時間或臨時突發事件，主辦單位有調整日期或更換講師之權利。
  4. 因課前教材、講義準備，若您不克前來，請於開課三日前告知，以利行政作業進行並共同愛護資源。
- 主辦單位保留報名資格之最後審核權利。

掃我報名

